

**OMNIMATE Housing – serie CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

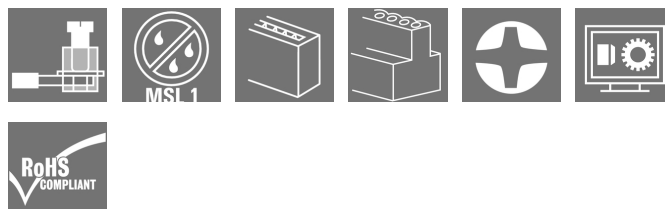
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Elektronikvärlden i en plint.**

Med en bredd på endast 6,1 mm kan elektronikutvecklaren med sitt Know-How skapa kompakta applikationsvärldar.

Det modulära kapslingskonceptet stöder konstruktionen med en rad intelligenta egenskaper:

- **Maximal designfrihet** genom stor netto-yta (6800 mm²) på kretskortet för maximal bestyckning genom platssparande geometri hos de reflow- och THR-anpassade stiftlisterna.
- **Individuella designmöjligheter** genom märknings- och färgalternativ för kapslingarna, samt variabelt och enkelt märkbart öppningsbart lock som kan bearbetas individuellt
- **Maximal effektivitet** i hanteringen genom reflow-kompatibla, automatanpassade anslutningselement för reflow-lödning förpackade i band.
- **Felfria bestycknings- och lödprocesser** genom optimerad ramgeometri för kretskortsutnyttjandet och stödgeometri för ett exakt läge hos anslutningselementen.
- **Tidssparande installation** tack vare egenskaper som "Wire Ready", eller den universella plus-minus-skruven

Elektronikutvecklarens Know-How och Weidmüllers kompetens - ett innovativt och framgångsrikt team vid skapandet av elektronikapplikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	LHZ-SMT L 1.5SN BK RL
Art.nr.	2418580000
Artikelbeteckning	Kretskortsplint, Anslutningselement vänster, Blockbyggsätt, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, Antal poler: 1, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Tape
GTIN (EAN)	4032248984350
Frp	432 Stück
Produktparametrar	IEC: 500 V / 0.2 - 2.5 mm ² UL:
Förpackning	Tape

OMNIMATE Housing – serie CH20M6

LHZ-SMT L 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	23,5 mm	Bygglängd (tum)	0,925 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0,236 inch
Höjd	16,9 mm	Bygghöjd (tum)	0,665 inch
Nettovikt	3,32 g		

Karakteristiska systemvärden

Utförande	Anslutningselement vänster	Anslutningstyp	Klämbygelanslutning
Antal anslutningar	1	Kretskortstjocklek	0,8 mm
Lödstiftlängd (l)	1,5 mm	Typ av kretskortskontaktering	Reflow
Kontakt till montageskena	Nej	Skyddsklass	IP20

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
CTI	≥ 175	Isolationshållfasthet	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktyta	förtennad	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	relativ fuktighet vid lagring, max	80 %
Drifttemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur, max	120 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	120 °C

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	13 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	13 A	Märkspänning vid överspanningsk./Nedsmutningsgrad II/2	500 V
Märkspänning vid överspanningsk./Nedsmutningsgrad III/2	320 V	Märkspänning vid överspanningskat./Nedsmutningsgrad III/3	250 V
Märkspänning vid överspanningsk./Nedsmutningsgrad II/2	4 kV	Märkspänning vid överspanningsk./Nedsmutningsgrad III/2	4 kV
Märkstötspänning vid överspanningsk./Nedsmutningsgrad III/3	4 kV		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002643
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-04-01
eClass 9.1	27-44-04-01		

Anmärkningar

Anmärkningar	
IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.

OMNIMATE Housing – serie CH20M6 LHZ-SMT L 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

**OMNIMATE Housing – serie CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

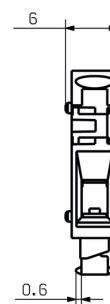
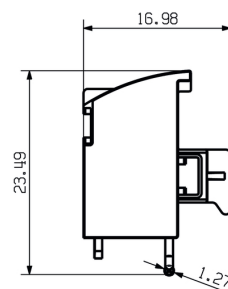
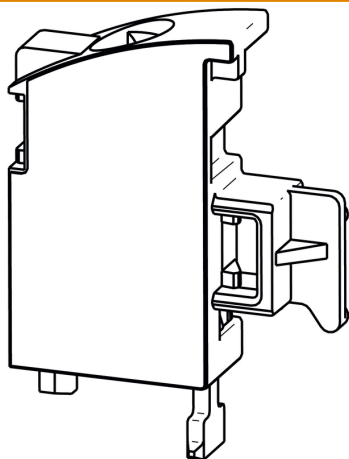
Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

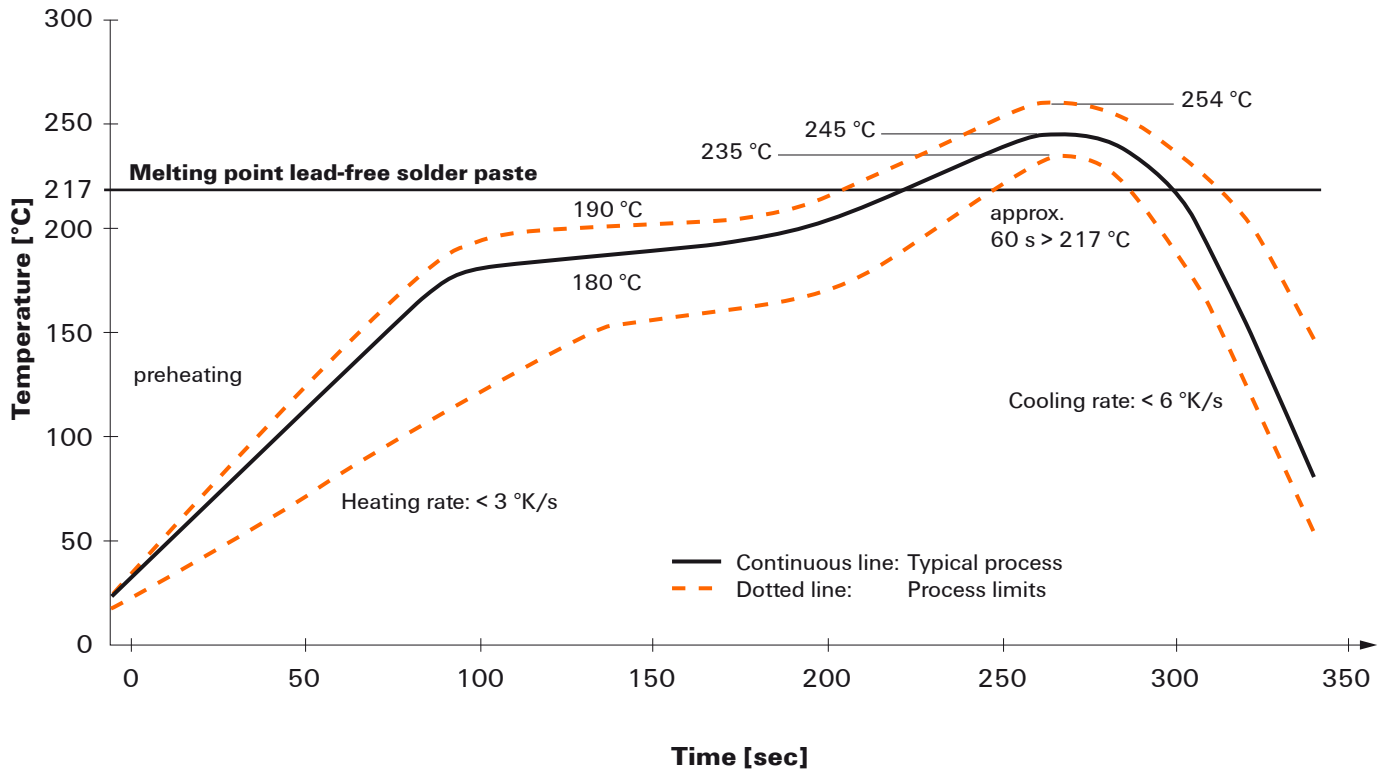
Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C . In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.